

Staff Scientist 양성프로그램 교육수행계획서(요약본)

1. 교육 개요

과정명	반도체 공정 관리자 양성과정(L1)	장비명	Photo Lithography, Etching, Thin-film, Diffusion, Packaging, Measurement
교육기간	12주 (33시간)	교육내용	<ul style="list-style-type: none"> · 클린룸 환경 이해 및 안전관리 실무 · 시설 인프라 및 유틸리티 운영의 이해 · 반도체 8대 공정 및 장비 운영의 이해 · 공정 운영 유의사항 및 장비 안정화 · 장비 운영관리 및 예방보전(PM) 실무
교육목적	반도체 공정 및 연구장비의 활용 역량뿐만 아니라, 클린룸 기반 연구시설의 운영·관리·안전 체계를 종합적으로 이해하고 관리할 수 있는 실무형 관리자 양성		
교육형태	연구시설 및 공정 이론, 연구시설 운영·관리, 연구장비 운용 및 공정 실습, 공정 결과 분석 및 문제 해결		

2. 교육 일정 및 내용

교육주차	연구장비 교육내용
1주차	클린룸 환경의 이해, 클린룸 위험요인과 안전관리
2주차	클린룸 시설 인프라의 이해, Photo Lithography 공정 및 장비 운영의 이해
3주차	유틸리티 시스템의 이해, Photo Lithography 장비 운영 유의사항 및 안정화
4주차	공정가스 공급 방식 이해, Photo Lithography 장비 관리 및 예방보전(PM)
5주차	Measurement(Surface profiler, Ellipsometer) 공정 및 장비 운영의 이해 Furnace 공정 및 장비운영의 이해
6주차	Thin-film 공정 및 장비운영의 이해 Measurement(Surface profiler, Ellipsometer) 장비운영 유의사항 및 안정화
7주차	Furnace 장비운영 유의사항 및 안정화 Thin-film(PE-CVD), Thin-film(Sputter) 장비 운영 유의사항 및 안정화
8주차	Measurement(Surface profiler, Ellipsometer) 장비운영 유의사항 및 안정화 Furnace 장비 관리 및 예방보전(PM)
9주차	Thin-film(PE-CVD, Sputter) 장비 관리 및 예방보전(PM)
10주차	Etching(Dry, Wet) 및 Wire bonder 공정 및 장비운영의 이해
11주차	Etching(Dry, Wet) 및 Wire bonder 장비운영 유의사항 및 안정화
12주차	Etching(Dry, Wet) 및 Wire bonder 장비 관리 및 예방보전(PM)